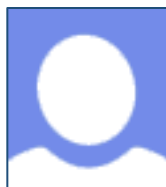


10月30日(金) 15:15-17:30

セッションチェアマン： 不破 保博(元ローム株)・森川 泰宏(株アルバック)

◆ Si-Cap 内蔵半導体基板技術(仮題)



株式会社村田製作所
技術・事業開発本部
事業インキュベーションセンター
iPas 事業推進部
iPas 開発 5 課
若岡 拓生

[講演要旨]

[講演者プロフィール]

◆ 3D パッケージ向け仮固定材同行と当社の取り組み(仮題)



積水化学工業株式会社
高機能プラスチックカンパニー
エレクトロニクス戦略室
理事 開発戦略グループ長
江南 俊夫

[講演要旨]

[講演者プロフィール]

◆ パネルレベルパッケージ向けデジタルリソグラフィシステム開発(仮題)



株式会社ニコン
精機事業本部
次世代事業開発統括部
プロジェクト推進室
松橋 佑介

[講演要旨]

[講演者プロフィール]

※本講演に興味を持たれた方は、こちらの講演もご覧になっています。

【D-1】技術・マーケットトレンド

【D-2】光電融合